

**EVG steigert Kapazität um über 60 Prozent – November 28, 2023**

**Starker Bedarf an Advanced Packaging**

**EVG steigert Kapazität um über 60 Prozent**

29. November 2023, 6:37 Uhr | [Heinz Arnold](#)



Fusions- und Hybrid-Bonding sind zu zentralen Technologien für die 3D- und Heterogene Integration und zu den neuen Skalierungsmechanismen für die Halbleiterproduktion geworden. Aufgrund der starken Nachfrage erweitert EVG die ihre Kapazität.

**EV Group (EVG) hat die mit der neuen »Fertigung V« die Produktions- und Lagerkapazität für die Fertigung zentraler Komponenten für ihre Waferbonding- und Lithographie-Maschinen deutlich erhöht.**

Der schnell wachsende Markt für Advanced Packaging und 3D- bzw. Heterogene Integration treibt die Nachfrage den Hybrid Bonding- und anderen Prozessen von EVG sowie ihrer Prozessentwicklungsdienstleistungen so stark voran, dass die Erweiterung erforderlich wurde. Weil die Nachfrage weiter steigt, befindet sich die nächste Expansionsstufe, die »Fertigung VI«, bereits im Bau.

Die moderne »Fertigung V« von EVG erweitert die Produktionsfläche um mehr als 1.200 m<sup>2</sup> auf insgesamt über 8.100 m<sup>2</sup>, darüber hinaus wächst die Lagerfläche um mehr als 1.200 m<sup>2</sup>. Über der

Produktionshalle entstanden zudem zwei neue Etagen mit Büroflächen. Parallel dazu wurde die bestehende »Fertigung II« umgebaut, um neun neue Testräume für die Endmontage und den Test der Präzisionsmaschinen von EVG sowie für deren technische Abnahme durch die Kunden bereitzustellen. Dies führte zu einer Vergrößerung der Testraumfläche am EVG-Headquarter um 30 Prozent auf insgesamt fast 2.800 m<sup>2</sup>.

#### **Matchmaker+** Anbieter zum Thema



[zu Matchmaker+](#)

Die moderne »Fertigung V« von EVG erweitert die Produktionsfläche um mehr als 1.200 m<sup>2</sup> auf insgesamt über 8.100 m<sup>2</sup>, darüber hinaus wächst die Lagerfläche um mehr als 1.200 m<sup>2</sup>.

Die Eröffnung der »Fertigung V« folgt direkt auf die vorherige Expansionsphase des Unternehmens, als mit der Ende letzten Jahres fertiggestellten »Fertigung IV« bereits fast 1800 m<sup>2</sup> Produktionsfläche und zusätzliche Lagerflächen hinzukamen. Seit Beginn dieser beiden, jüngsten Wachstumsphasen hat EVG seine Produktionskapazität um mehr als 60 Prozent erweitert. Die »Fertigung VI«, mit zusätzlichen 1.400 m<sup>2</sup> Produktions- und ebenso viel Lagerfläche, soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt werden.

#### **Fusions- und Hybrid-Bonding stehen im Zentrum**

»Neue Anwendungen, die die Halbleiterindustrie vorantreiben, wie künstliche Intelligenz, Hochleistungs-Computing und autonomes Fahren, erfordern massive Innovationen im Bereich Advanced Packaging. Dabei sind Fusions- und Hybrid-Bonding als zentrale Technologien für die 3D- und Heterogene Integration zu den neuen Skalierungsmechanismen für die Halbleiterproduktion geworden«, sagt Dr. Werner Thallner, Executive Operations and Financial Director sowie Mitglied des Executive Boards von EVG. »Die stetig wachsende Nachfrage nach unseren Produkten im Laufe der Jahre hat uns dazu veranlasst, große Investitionen in die Erweiterung unserer Produktions- und Reinraumkapazitäten zu tätigen, um den steigenden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir gehen fest davon aus, dass sich dieses Nachfragewachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird.«

Blick in die neuen Räumlichkeiten von EVG am Hauptsitz in St. Florian/Österreich.

#### **Systeme für die Heterogene Integration**

Die Waferbonder, Lithographie- und Messtechniksysteme von EVG ermöglichen die Entwicklung und Hochvolumenfertigung von Innovationen im Bereich Advanced Packaging – einschließlich rückseitig belichteter CMOS-Bildsensoren und anderer, gestapelter 3D-ICs – sowie im Bereich MEMS und Verbindungshalbleiter. Jüngste Durchbrüche im Hybrid-Bonding zur Erfüllung der Anforderungen an die 3D-Integration von Devices, beim Wafer-Bond-Alignment für zukünftige Anforderungen beim 3D-IC-

Packaging, bei der IR-Laser-Release-Technologie zum Ersatz von Glassubstraten beim Advanced Packaging und zur 3D-Stapelung dünnster Schichten, der maskenlosen Belichtung für das Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP) sowie bei NIL-Anwendungen und der Resist-Verarbeitung zur Herstellung von Wafer-Level-Optiken (WLO) sind nur einige Beispiele für die Technologien von EVG in den Bereichen Heterogene Integration und Wafer-Level-Packaging, in denen sich das Unternehmen in einer weltweit führenden Position sieht.

<https://www.elektroniknet.de/halbleiter/evg-steigert-kapazitaet-um-ueber-60-prozent.212178.html>